

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2022年8月4日(04.08.2022)



(10) 国際公開番号

WO 2022/163610 A1

- (51) 国際特許分類:
G03F 7/004 (2006.01) *G03F 7/037* (2006.01)
G03F 7/025 (2006.01) *H05K 3/28* (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2022/002548
- (22) 国際出願日: 2022年1月25日(25.01.2022)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2021-014112 2021年2月1日(01.02.2021) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社 (TORAY INDUSTRIES, INC.) [JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 桂田悠基 (KATSURADA, Yuki); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 小林悠太 (KOBAYASHI, Yuta); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 金森大典 (KANAMORI, Daisuke); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

一 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) **Title:** PHOTSENSITIVE RESIN COMPOSITION, PHOTSENSITIVE RESIN SHEET, CURED PRODUCT, HOLLOW STRUCTURE, ELECTRONIC COMPONENT, AND ELASTIC WAVE FILTER

(54) 発明の名称: 感光性樹脂組成物、感光性樹脂シート、硬化物、中空構造体、電子部品および弾性波フィルター

(57) **Abstract:** The purpose of the present invention is to provide a photosensitive resin composition having excellent pattern processability and pressure resistance. The present invention is a photosensitive resin composition comprising (A) a polymer, (B) a radically polymerizable compound, (C) a photopolymerization initiator, and (D) an inorganic filler, wherein the radically polymerizable functional group equivalent of the (B) radically polymerizable compound is 70-200 g/eq on average.

(57) 要約: 本発明の目的は、パターン加工性および耐圧性に優れた感光性樹脂組成物を提供することである。本発明は、(A) ポリマー、(B) ラジカル重合性化合物、(C) 光重合開始剤、及び(D) 無機フィラーを含む感光性樹脂組成物であって、前記(B) ラジカル重合性化合物のラジカル重合性官能基当量が、平均で70g/eq以上200g/eq以下である、感光性樹脂組成物である。



WO 2022/163610 A1